

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-076

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份、公司”）于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段发展需求的迫切程度及公司整体经营发展布局，同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目——“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”（以下简称“原项目”）尚未使用的部分募集资金用于“光电半导体材料研发制造中心项目”（以下简称“新项目”），本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。该事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。现将相关事项说明如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 89,711.78 万元。

上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转债的募集资金到位情况进行了审验，并由其于 2025 年 4 月 9 日出具了《湖北鼎龙控股股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082 号。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金净额	截至 2025 年 9 月 30 日募集资金累计使用金额
1	年 产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目	80,395.30	48,000.00	36,031.67
2	光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目	23,458.74	17,000.00	1,069.33
3	补充流动资金项目	26,000.00	24,711.78	14,831.92
合计		129,854.04	89,711.78	51,932.92

（三）拟变更募集资金投资项目概况

考虑“光电半导体材料研发制造中心”实施更具迫切性，更符合公司现阶段市场拓展以及发展战略布局之需，公司本次拟将“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”尚未使用的部分募集资金用于“光电半导体材料研发制造中心项目”。

“光电半导体材料研发制造中心项目”由鼎龙股份实施，总投资金额 28,818.00 万元，拟使用募集资金 15,500.00 万元，项目建设期为 3 年。新项目位于公司现厂区以西，主要建设 9 层研发制造中心，并将同时购置分析评价验证设备、抛光垫设备、预聚体设备、微球发泡设备、磨料设备等相关设备，同步配套建设场区道路、水电、消防、环保等基础设施。项目投产后，形成光电半导体材料研发、分析检测、应用评价能力，并将形成年产 4000 吨预聚体、200 吨微球发泡、40 万片大硅片抛光垫、30 吨氧化铝磨料、50 吨氧化铈磨料的生产能力。同时，考虑集团内部各子公司业务板块定位以及为提升项目运营效率、优化资源配置等，本项目中预聚体、微球、大硅片抛光垫、磨料等相关产品生

产车间及配套生产设备等由鼎龙股份投建完成后，将通过出租给相关业务子公司运营方式实施。

具体变更情况如下：

单位：万元

变更前				变更后			
项目名称	实施主体	投资总额	募集资金拟投入金额	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金拟投入金额
光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目	鼎龙（仙桃）新材料有限公司	23,458.74	17,000.00	光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目	鼎龙（仙桃）新材料有限公司	23,458.74	1,500.00
				光电半导体材料研发制造中心项目	湖北鼎龙科技股份有限公司	28,818.00	15,500.00
合计		23,458.74	17,000.00	合计			17,000.00

上述拟变更用途的募集资金金额占募集资金总额 91,000.00 万元的 17.03%。

调整后的募投项目实施主体将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、变更部分募投项目的原因

（一）拟变更募投项目计划和实际投资情况

- 1、原项目名称：光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目
- 2、原项目实施主体：鼎龙（仙桃）新材料有限公司
- 3、原项目实施地点：仙桃市西流河镇周滩村（仙河大道北侧）公司鼎龙（仙桃）产业园内
- 4、原项目产品方案：主要研发及生产半导体工艺材料上游关键原材料（聚氨酯预聚体和微球）、半导体显示材料上游关键原材料（二胺、聚酰亚胺树脂、丙烯酸系衍生物和酚醛树脂），所产产品配套用于鼎龙股份内部下游产品的生产，不对外出售。
- 5、原项目实施周期：两年

6、原项目投资规划：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	是否属于资本化支出	拟投入募集资金额
一	工程投资	20,336.80	-	17,000.00
1	主体工程建设	2,062.50	是	1,500.00
2	公用及辅助工程	793.07	是	500.00
3	设备及安装工程	15,240.75	是	15,000.00
4	其他	1,272.06	是	0
二	预备费及铺底流动资金	3,121.93	否	0
合计		23,458.74	-	17,000.00

7、原项目实际投资进度：截至 2025 年 9 月 30 日，已实际使用募集资金 1,069.33 万元，累计投入进度为 6.29%，剩余募集资金及其孳息 15,934.47 万元。

（二）变更募投项目的原因

1、统筹资源配置，集中力量优先发展优势业务

公司目前的前瞻研究主要由武汉总部负责，抛光垫、抛光液的主要研发人员亦主要在武汉总部园区内开展工作，同时，抛光垫和抛光液的主要经营主体鼎汇微电子和武汉鼎泽亦位于武汉总部园区内，相关经营活动也在武汉总部园区内开展。新项目实施地位于武汉总部现有厂区西侧，从实施地角度来看，新项目更有利于统筹资源，实现研发与检测环节的集中化；便于集团统一管理协同，以及便于研发、工艺、生产和销售等经营活动的集约高效实施，进一步提升运营效益。

同时，新项目拟进一步放大优势产品 CMP 抛光垫及上游核心材料、CMP 抛光液上游核心材料的产能规模，有助于进一步提升优势业务板块的供应能力和关键原材料供应链的安全稳定性。

2、审慎考量项目实施的轻重缓急，新项目实施需求更为迫切，更符合公司现时发展战略

随着晶圆制造用 CMP 抛光垫产品技术成熟度与市场渗透程度的持续提升，公司 CMP 抛光垫业务的未来发展重点已拓展至大硅片抛光垫领域，产能布局已迫在眉睫。与此同时，搭载氧化铝研磨粒子的 CMP 抛光液以及采用自产氧化锆

磨料的 CMP 抛光液产品，在客户端的验证导入提速，批量供货能力亟需加强，现有氧化铝、氧化铈研磨粒子的产能预期无法满足客户需求以及市场增长潜力。

此外，客户对订单交付时效与服务响应效率要求较高，为敏捷应对市场变化，巩固并提升竞争优势，公司亦须加快建设大硅片抛光垫产能，持续完善 CMP 抛光垫产品供应链自主化进程，并须尽快放大 CMP 抛光液所用铝磨料与铈磨料产能供应能力，以切实提升供应链安全性以及产品交付能力。由此，“光电半导体材料研发制造中心项目”产品产能的建设任务相对更为紧迫，具备更高的战略优先级，使用募集资金投建可加速本项目开展，更有利于提升公司市场地位。

3、优化资金配置，提升使用效率

“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”已顺利完成部分关键原材料微球等产品的产能建设，考虑项目市场需求、产品成熟度以及客户拓展情况，公司后续拟结合项目进展等主要以自有资金方式投入，而使用募集资金支持新项目所涉研发检测资源以及关键材料的布局。本次调整可更好地匹配资金使用节奏与业务发展需求，有助于进一步提高募集资金使用效率，助力公司把握当前关键发展窗口。

三、新募投项目情况说明

（一）新项目的基本情况和投资计划

1、项目名称：光电半导体材料研发制造中心项目

2、项目实施主体：湖北鼎龙控股股份有限公司

3、项目实施地点：湖北省武汉市武汉经济技术开发区 54MB 地块，具体位于武监高速和东荆河路交叉口处，鼎龙股份现厂区以西，北侧紧靠东荆河路，东侧紧靠鼎龙厂区内道路，南侧可远眺通顺河。公司已取得土地使用权（权证编号：鄂（2025）武汉市经开不动产权第 0012786 号）

4、新项目产品方案：本项目主要建设 9 层研发制造中心，购置分析评价验证设备、抛光垫设备、预聚体设备、微球发泡设备、磨料设备等相关设备，配套建设场区道路、水电、消防、环保等基础设施。项目投产后，形成光电半导

体材料研发、分析检测、应用评价能力，并将形成年产 4000 吨预聚体、200 吨微球发泡、40 万片大硅片抛光垫、30 吨氧化铝磨料、50 吨氧化铈磨料的生产能力。

5、新项目实施周期：三年

6、新项目投资规划：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	是否属于资本化支出	拟投入募集资金额
一	工程费用	24,715.43	是	15,500.00
二	工程建设其他费用	1,967.90	是	0.00
三	预备费及铺底流动资金	2,134.67	否	0.00
合计		28,818.00	-	15,500.00

7、新项目备案等审批程序：截至本公告日，本项目已取得《湖北省固定资产投资项目备案证明》（登记备案项目代码：2509-420113-04-01-667136），环境影响评价工作正在开展中。

8、新项目实施方式：本项目将由鼎龙股份整体统筹，负责投资建设以及建设完成后研发、分析检测、应用评价等相关工作的开展；同时，考虑子公司业务及板块定位，为提升项目运营效率以及优化资源配置，相关产品的加工制造场地及设备由鼎龙股份投建完成后，将分别出租给相关并表子公司运营。

9、新项目经济效益评价：由于本项目采用的实施方式，鼎龙股份作为投资建设以及研发、检测、评价等的实施主体，主要作为投资及研发支出承担主体，不直接体现经济效益。鼎龙股份聚焦集团化协同战略，通过平台化运作集中资源承担重资产投入，为子公司提供坚实支撑。子公司则专注市场前端，轻装拓展。此举有效实现资源整合与战略协同，提升整体抗风险能力与综合效益，最终实现集团整体价值最大化。本项目的实施将进一步提供公司在光电半导体领域的研发、检测评价及生产能力，巩固提升市场地位和核心竞争力，提升盈利能力。

（二）新项目的可行性分析

1、新项目的必要性

（1）立足发展现状，加强光电半导体材料验证检测力量，为企业研发及生产提供重要科学技术支撑的需要

作为光电显示及半导体产业的重要环节，检测验证一直以来备受关注。随着光电显示及半导体制程工艺不断进步，测试和验证也变得越来越重要。目前，人工智能、大数据及物联网等信息技术的发展，推动光电显示及半导体产业迎来新一轮景气周期。为解决需求及供给不匹配的矛盾，我国正在积极完善光电显示及半导体等相关产业链布局。但随着如今光电显示材料快速迭代、半导体芯片晶体管密度越来越高，相关产品复杂度及集成度呈现指数级增长，这对于显示材料及半导体材料设计研发和制造而言是一种挑战。另一方面，随着半导体制程工艺不断进步，需要面临大量的技术挑战，光电及半导体材料测试和验证也变得尤为重要。与此同时，新兴产业的发展也进一步凸显半导体材料检测验证评价的重要性。因此在研发设计及生产过程中，测试验证就变得尤为重要。只有准确测量组件的各个参数，才能相应的优化设计方案，提升产品良率，从而推动我国光电半导体材料技术水平的整体提升。

公司坚持材料技术创新与用户验证工艺发展同步，此前已形成 CMP 抛光材料、新型显示材料、先进封装材料、晶圆光刻胶、打印复印通用耗材等应用评价验证体系，拥有丰富的材料检测验证经验。但随着公司业务规模持续扩展、产品线布局不断丰富、客户数量持续开拓，公司各创新材料领域的检测验证需求不断增加，检测验证资源的紧张将一定程度上延缓公司半导体业务的推进速度。

新项目的实施是立足于鼎龙股份半导体及显示材料研发现状，针对性地设置相应的材料测试验证评价中心，对公司重点光电半导体材料进行测试验证，为公司各类材料研发及生产提供重要科学技术支撑力量。

（2）推进战略性新兴材料领域科技创新，提升产业自主发展能力，满足国家在关键核心技术领域取得突破的迫切需要

光电半导体材料是现代电子信息产业的基础，其技术能力与供应链稳定性对国家产业发展与科技进步具有重要影响。当前，全球半导体材料技术发展迅速，在 CMP 抛光材料、高端光刻胶、先进封装材料等关键领域，国际企业凭借

长期积累，在核心专利、生产工艺与质量控制方面建立了体系化的技术优势。要在全球竞争中提升我国半导体产业整体水平，必须在关键材料环节加快实现技术突破，构建起可持续的创新能力与供应链体系。

新项目通过建设集成电路 CMP 材料、晶圆光刻胶、半导体先进封装材料和新型显示材料四大测试验证评价中心，持续完善公司系统化的材料创新平台，依托鼎龙股份行业龙头的技术积累，满足公司各项材料的研发生产需求，助力企业研发加快材料研发生产进程，提升我国在新一代信息技术产业用材料领域的自主创新水平和全球竞争能力。

（3）为光电半导体材料的产业化提供技术积累和材料产出，助推区域“光芯屏端网”材料产业加速发展的需要

近年来，湖北省坚持创新发展，大力发展先进制造业，构建“51020”现代产业体系，着力提升产业基础能力和产业链现代化水平，推动湖北制造向质量效率型、高端引领型转变。为积极落实湖北省产业发展整体导向，“十四五”期间，武汉市产业集群发展主要围绕“965”产业体系展开，即九大支柱产业、六大战略性新兴产业和五大未来产业，“光芯屏端网”作为支柱产业之首重点推进。在这一战略布局中，光电半导体材料作为产业最基础也是最关键的环节，其技术成熟度和产业化水平直接决定着整个产业的竞争力和安全性。新项目的建设积极落实这一产业布局，通过构建完善的测试验证体系和规模化生产能力，为区域“光芯屏端网”产业提供高质量的材料保障。

项目通过建设集成电路 CMP 材料、新型显示材料、半导体先进封装材料及晶圆光刻胶四大测试验证评价中心，解决从实验室研发到产业化放大量产过程中的工艺适配性、产品一致性和可靠性等关键问题，加速新材料从样品开发到批量应用的转化进程。

特别是针对 CMP 抛光垫、抛光液等已实现技术突破的产品，项目将通过专业化产线建设，扩大大硅片用抛光垫的产能规模，助力其市场开拓；建成微球合成后的微球发泡工艺产线，完善抛光垫用预聚体产能布局，强化 CMP 抛光垫供应链自主化程度；补充氧化铝、氧化铈类研磨粒子的产能规模，完善 CMP 抛

光液及其配套研磨粒子全品类布局的战略规划，提升产品质量稳定性，满足下游晶圆制造和显示面板企业日益增长的国产化采购需求。

新项目实施后将显著增强区域产业链的本地化配套能力，通过就近供应降低下游企业采购成本和供应链风险，形成产业链上下游协同发展的良好格局，带动区域内相关材料企业的技术创新和产品升级，提升整个“光芯屏端网”产业集群的发展能级。

2、新项目的可行性

（1）国家产业政策的支持为项目顺利实施提供了政策保障

半导体产业作为战略性、基础性先导产业，其关键材料的自主化已被列为重点发展方向。《中国制造 2025》等政策文件明确将高端半导体材料作为重点突破领域，从产业引导、税收优惠等多方面提供支持。本项目所涉及的大硅片抛光垫、预聚体及高端抛光液研磨粒子，是芯片制造中化学机械抛光（CMP）环节的核心材料，高度契合国家政策导向，为项目推进创造了有利条件。

（2）广阔的市场前景为新项目的顺利实施奠定了市场基础

随着 5G、人工智能、物联网、新能源汽车等下游应用的快速发展，全球及中国半导体芯片需求持续增长，带动了对上游半导体材料的强劲需求。芯片制程的不断进步和硅片大尺寸化发展趋势，对 CMP 抛光垫和抛光液的性能要求与消耗量同步提升。本项目布局的大硅片抛光垫、预聚体、微球发泡及高端抛光液研磨粒子，正是顺应这一市场趋势，规划的产能规模与客户需求增长相匹配，为新增产能的消化提供了充分的市场空间。

（3）公司深厚的技术积累与成熟的质量控制体系，为新项目的顺利实施提供了坚实的技术支撑与质量保障

公司在 CMP 抛光材料领域经过多年发展，已建立显著的技术优势。在抛光垫方面，掌握了从预聚体合成到微球发泡等核心工艺；在抛光液方面，在氧化铝、氧化铈研磨粒子的制备、改性及配方技术上取得关键突破。项目将配套建设研发、分析和应用评价能力，进一步增强技术创新能力。同时，公司成熟的质量控制体系已通过下游多家高端客户的多轮次稽核，确保项目产品能够快速达到业界领先水平。

四、风险提示

（一）审批风险

公司本次变更募投项目事项尚待股东会和债券持有人会议审议通过后方可实施，存在审批风险。

（二）实施风险

项目在建设及后续运营过程中受到宏观政策、市场环境等诸多因素的影响，如出现宏观政策发生变化、市场环境恶化等因素，可能会出现实施进度不及预期，出现顺延、变更、中止或终止的风险。

（三）风险应对措施

公司将密切关注市场动态，根据公司实际情况对募集资金投资进行适时安排，加强对项目进行监督检查和评估，以最大程度降低有关风险事项对新项目顺利实施的不利影响。

五、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响

本次变更向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，有利于提升募集资金使用效率，符合公司发展战略规划及当前面临的市场环境，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目是公司根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规的规定。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

六、履行的审议程序

公司于2025年10月31日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目——“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”尚未使用的部分募集资金用于“光电半导体材料研发制造中心项目”；同时授权公司董事长及董事长授权人士全权办理与开立募集资金专户

和签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，审计委员会、独立董事、保荐机构同意本次变更事项，该议案尚需提交股东会和债券持有人会议审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，招商证券股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金投资项目相关事宜，已经公司董事会审议通过，且审计委员会、独立董事同意本次变更事项，履行了必要的审议程序，目前尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。公司本次拟变更部分募集资金投资项目是结合当前市场环境及公司经营发展布局等客观情况审慎做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的行为。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

招商证券对公司本次变更部分募集资金投资项目相关事项无异议，不影响前期保荐意见的合理性。同时，招商证券将继续督促公司加强募集资金投资项目管理，及募集资金使用监管，并督促其及时履行信息披露义务。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议记录；
- 3、第六届董事会独立董事第二次专门会议审核意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司变更向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2025年11月1日